

【第3回】車載半導体の安定調達に向けた取り組みに関する説明会 ～#2 車載半導体データプラットフォーム～

モビリティ産業7つの課題の1つである「半導体の国際競争力確保」に向け、これまで日本自動車工業会（JAMA）と日本自動車部品工業会（JAPIA）は両会にWG（ワーキンググループ）を設置し、まずは車載半導体の安定調達に資する取り組みを連携して進めて参りました。

前回の説明会（1/14）に続き、業界共通の車載半導体データプラットフォームについて、説明会を開催いたしますので、下記の通りご案内をさせていただきます。

日 時：令和8年2月26日（木） 10:00～12:00（2時間）

場 所：オンライン開催

※Zoomでのオンライン開催 ※視聴 URL は申込者へ別途送付いたします。

主 催：一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人日本自動車部品工業会（JAPIA）

自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター（ABtC）

※以下、自工会、部工会、ABtCにて省略

次 第：

	議題	説明者	時間
1	自工会「7つの課題」と取り組みの背景	自工会 半導体 WG	5分
2	車載半導体データ PF の取り組み概要と狙い	自工会 半導体 WG	5分
3	車載半導体 DPF アプリケーション説明（Q&A 含む）	ABtC	40分
4	サービス概要説明（費用・契約・手続きフロー）	ABtC	10分
5	依頼事項	自工会/部工会/ABtC	5分
6	質疑応答	自工会/部工会/ABtC	55分
	計		120分

※次第内容、説明者は変更になる場合がございます。

【申込要領】

参加企業：自工会 会員企業と車載半導体を取り扱っている部工会 会員企業およびそのグループ会社

※グループ会社様につきましては、会員企業様より本案内の展開をお願いいたします。

※上記以外は、自工会経由にて OEM より案内を実施。

半導体メーカー20社

参加対象者：車載半導体またはそれを搭載する部品の購買・調達を担当している部門の管理者または担当者

定 員：回線上限数 500（Zoom ウェビナー）

※定員に達した場合などは回線数を調整(減らして)いただく場合もございます。予め御了承ください。

入 場 料：無料

申 込 方 法：参加希望の方は以下のサイトにアクセスし、お申し込みください。

※1回線で複数名が視聴される場合は1度の申し込みで結構です。

https://www.japia.or.jp/0827handotai_session/

申込締切日：令和8年2月20日（金）

そ の 他：当日の説明会動画を後日ホームページ上にアーカイブ配信を予定しております。

問 合 せ 先：一般社団法人 日本自動車部品工業会 業務部 伊藤、田中

電話 03-3445-4214 ito-sota@japia.or.jp